

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年7月6日(06.07.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/127378 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/52 (2006.01) H01L 25/065 (2023.01)
H01L 25/07 (2006.01) H01L 25/18 (2023.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/044032

(22) 国際出願日: 2022年11月29日(29.11.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-213386 2021年12月27日(27.12.2021) JP

(71) 出願人: 古河電気工業株式会社(FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 森田 稔(MORITA, Minoru); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 梶原 知人(KAJIHARA, Tomohito); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株

式会社内 Tokyo (JP). 大谷 洋多(OTANI, Yota); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 丸山 弘光(MARUYAMA, Hiromitsu); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人イイダアンドパートナーズ, 外(IIDA & PARTNERS et al.); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,

(54) Title: ADHESIVE AGENT COMPOSITION, FILM-LIKE ADHESIVE AGENT, SEMICONDUCTOR PACKAGE USING FILM-LIKE ADHESIVE AGENT, AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: 接着剤用組成物及びフィルム状接着剤、並びに、フィルム状接着剤を用いた半導体パッケージ及びその製造方法



(57) Abstract: The present invention provides: an adhesive agent composition containing an epoxy resin (A), an epoxy resin curing agent (B), a polyurethane resin (C), and an inorganic filler (D), wherein the polyurethane resin (C) has an elastic modulus at 25°C of at least 8.0 MPa, as measured by dynamic viscoelasticity, the proportion of the polyurethane resin (C) in the total of the respective amounts of the epoxy resin (A) and the polyurethane resin (C) is 2.0-50.0 mass%, and a film-like adhesive agent formed using the adhesive agent composition has a maximum tensile stress value of at least 7.0 MPa on a stress-strain curve when a tensile force is applied thereto; a film-like adhesive agent using the adhesive agent composition; a semiconductor package; and a method for producing the same.

(57) 要約: エポキシ樹脂 (A)、エポキシ樹脂硬化剤 (B)、ポリウレタン樹脂 (C) 及び無機充填材 (D) を含有する接着剤用組成物であって、前記ポリウレタン樹脂 (C) の、動的粘弾性測定における 25°C の貯蔵弾性率が 8.0 MPa 以上であり、前記エポキシ樹脂 (A) 及び前記ポリウレタン樹脂 (C) の各含有量の合計に占める前記ポリウレタン樹脂 (C) の割合が 2.0~50.0 質量%であり、前記接着剤用組成物を用いて形成したフィルム状接着剤に引張力を負荷した際の応力-ひずみ曲線の引張最大応力値が 7.0 MPa 以上である、接着剤用組成物、これを用いたフィルム状接着剤、半導体パッケージ及びその製造方法。

WO 2023/127378 A1

[続葉有]

PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))